

® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

® Offenlegungsschrift

_® DE 100 06 257 A 1

Aktenzeichen:

100 06 257.1

Anmeldetag:

11. 2.2000

(4) Offenlegungstag:

14. 9. 2000

(a) Int. Cl.⁷: H 01 L 29/786 H 01 L 51/20 H 01 L 51/30

(D) Unionspriorität:

261515

03.03.1999 US

(7) Anmelder: IBM Corp., Armonk, N.Y., US

(4) Vertreter:

Teufel, F., Dipl.-Phys., Pat.-Anw., 70569 Stuttgart

(7) Erfinder:

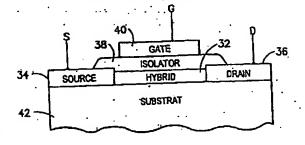
Chondroudis, Konstantinos, North White Plains, N.Y., US; Dimitrakopoulos, Christos D., West Harrison, N.Y., US; Kagan, Cherie R., Ossining, N.Y., US; Kymissis, Ioannis, New Hyde Park, N.Y., US

Die feigenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Dünnfilmtransistoren mit organisch-anorganischen Hybridmaterialien als halbleitende Kanäle

Eine FET-Struktur gemäß der erfindung verwendet ein organisch-anorganisches Hybridmaterial als halbleitenden Kanal zwischen Source- und Drain-Elektroden des Bauelements. Das organisch-anorganische Material kombiniert die Vorteile eines anorganischen, kristallinen Feststoffes mit jenen eines organischen Materials. Die anorganische Komponente bildet ein ausgedehntes, anorganisches ein, zwei- oder dreidimensionales Netzwerk, um die Eigenschaft hoher Trägerbeweglichkeiten von anorganischen, kristallinen Feststoffen bereitzustellen. Die organische Komponente erleichtert den Selbstaufbau dieser Materialien und ermöglicht, daß die Materialien durch einfeche Niedertemperatur-Prozeßbedingungen aufgebracht werden können, wie Aufschleudern, Eintauchbe-schichtung oder thermische Verdampfung. Die organische Komponente wird außerdem dazu verwendet, die elektronischen Eigenschaften des anorganischen Netzwerkes maßzuschneidern, Indem sie die Dimensonalität der anorganischen Komponente und die elektronische Kopplung zwischen anorganischen Einheiten definiert.



Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

Diese Erfindung bezieht sich auf Dünnfilm-Feldeffekttransistorstrukturen (thin film field effect transistor structures) und spezieller auf solche Transistorstrukturen, die organisch-anorganische Hybridmaterialien als halbleitende Kanäle darin verwenden.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Dünnfilmtransistoren (thin film transistors), bekannt als TFTh, werden vielfach als Schaltelemente in der Riektronik verwendet, insbesondere für großflächige Anwendungen, 15 wie Filssigkristallanzeigen mit aktiver Matrix. Der TFT ist ein Beispiel für einen Feldeffekttransistor (FBT: field effect transistor). Der am besten bekannte FBT ist der MOSFBT (Metall-Oxid-Halbleiter-FBT) (Metall-Oxide-Semiconductor-FBT), das herkömmliche Schaltelement von heute für elektronische Hochgeschwindigkeitsamwendungen. Während sich der MOSFBT speziell auf SiO₂/Volumen-Si-Transistoren bezieht, sind allgemeinere Kombinationen von Metall-Isolator-Halbleitern als MISFETs bekannt. Der TFT ist ein MISFBT, bei dem die aktive Halbleiterschicht als Dünntfilm aufgebracht ist.

Gegenwärtig werden TFIs in den meisten Bauelementen unter Verwendung von amorphem Silicium als dem Halbleiter hergestellt. Amorphes Silicium stellt eine billigere Alternative gegenüber kristallinem Silicium bereit – eine notwendige Bedingung für eine Reduzierung der Kosten von Transistoren, die in großflächigen Anwendungen verwendet werden. Die Anwendung von amorphem Silicium ist auf Bauelemente mit geringeren Geschwindigkeiten beschränkt, da seine Beweglichkeit, ~10~1 cm²/V · sec, 15.000×kleiner als 35 jene von kristallinem Silicium ist. Wenngleich amorphes Silicium kostengünstiger aufzubringen ist als kristallines Silicium kostengünstiger aufzubringen ist als kristallines Silicium, erfordert die Deposition von amorphem Silicium dennoch kostspielige Prozesse, wie plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung (plasma enhanced chemical 40 vapour deposition).

In der letzten Zeit haben organische Halbleiter Beachtung als potentielle Halbleiterkomponenten für TFTs gefunden. Siche zum Beispiel US-Patent 5 347 144 für Garnier et al. mit dem Titel "Thin-Layer Field Rffect Transistors With 45 MIS Structure Whose Insulator and Semiconductor Are Made of Organic Materials". Organische Materialien (z. B. kleine Moleküle, kurzkettige Oligomere und Polymere) können eine weniger kostenintensive Alternative zu anorganischen Materialien filr TFT-Strukturen sein, da sie durch 50 Verfahren wie Aufschleudern (spin-coating), Eintauchbeschichtung (dip-coating) aus einer Lösung, thermische Verdampfung (thermal evaporation) oder Siebdrucken (screen printing) einfacher herzustellen sind. Wenngleich die Beweglichkeiten von organischen Materialien verbessert wur- 55 den, sind ihre Beweglichkeiten dennoch weiterhin gering, und lediglich die besten Materialien weisen Beweglichkeiten auf, die jenen von amorphem Silicium nahekommen,

Organische Halbleiter sind weniger teuer und leichter aufzubringen als herkömmliches, amorphes Silicium. Derartige organische Materialien sind entweder kleine Moleküle (z. B. Pentacen, Metall-Pinhalocyanine), kurzkettige Oligomere (z. B. n-Thiophene mit n = 3 bis 8), oder langkettige Polymere (z. B. Polyalkylthiophene oder Polyphenylenvinylene). Ein atomares orbitales Übertappen zwischen benachbarten, mehrfach gebundenen Atomen, bekannt als Konjugation, ermöglicht den Transport von Ladung entlang von Molekülen, Oligomeren und Polymeren. Ein molekula-

res orbitales Überlappen zwischen benachbarten Molekülen ermöglicht einen intermolekularen Ladungstransport.

Dünne Filme aus kleinen Molekülen oder kurzkettigen Oligomeren zeigen die höchsten Beweglichkeiten für organische Materialien. Die kleinen Moleküle/kurzkettigen Oligomere, die diese bohen Beweglichkeiten zeigen, wurden durch thermische Verdampfung aufgebracht, wobei sie als bochgradig geordnete Dünnfilme abgeschieden werden. Der bohe Grad an Ordmung in den Filmen liefert eine orbitsele Überlappung und daher einen Ladungstransport zwischen benachbarten Molekülen. Langkettige Polymere sind vorteilhaft, da sie löslicher sind, was eine Deposition durch preiswerte Techniken, wie Aufschleudern und Eintauchbeschichtung, ermöglicht, sie weisen jedoch geringere Beweglichkeiten auf, da sie ungeordneter sind.

Wenngleich organische Materialien die Möglichkeit der Aufbringung von Halbleitern für TFTs durch kostengünstigere und einfachere Depositionstechniken eröffnen, wie thermische Verdampfung, Aufschleudern und Eintauchbeschichtung, sind ihre Beweglichkeiten dennoch geringer als erwitnscht. Typische Beweglichkeiten für kleine Molekille/ Oligomere liegen im Bereich kurzkettige 10⁻³ cm²/V·sec bis 10⁻¹ cm²/V·sec, und für langkettige Polymere liegen sie im Bereich von 10⁻⁸ cm²/V·sec bis 10⁻² cm²/V ⋅ sec, Die höchsten Beweglichkeiten, die berichtet wurden, sind 0,7 cm²/V · sec für Dünnfilme aus Pentacen und 0,13 cm²/V · sec für Dünnfilme aus Dihexyl,α-sexithiophen. Eine Beweglichkeit von 0,3 cm²/V · sec, die für einkristallines or-Sexithiophen gemessen wurde, repräsentiert die Obergrenze der Beweglichkeit für dieses Material. Die Beweglichkeiten von organischen Halbleitern konkurrieren mit jenen von amorphem Silicium.

Organisch-anorganische Hybridmaterialien sind eine bestimmte Klasse von Materialien, die das Kombinieren der mützlichen Eigenschaften von organischen und anorganischen Komponenten innerhalb eines einzigen Materials ermöglichen, Rinige Elemente dieser Klasse von Materialien zeigen halbleitende Eigenschaften. Für die Zwecke dieser Beschreibung ist ein organisch-anorganisches Hybridmaterial ein Material, das besteht aus: organischen Komponenten und anorganischen Komponenten, die auf einem molekularen Niveau zusammengemischt werden, wobei (i) das Material durch ein im wesentlichen festes Verhältnis von jeder organischen Komponente zu jeder anorganischen Komponente charakterisiert ist; wobei (ii) wenigstens eine Komponente halbleitend ist; und wobei (iii) sowohl organische als auch anorganische Komponenten Kräfte zeigen, die einen Selbstaufbau zwischen diesen in eine vorhersagbare Anordnung ermöglichen.

Ein Beispiel für ein organisch-anorganisches Hybridmaterial besitzt die Form einer organisch-anorganischen Perovskit-Struktur. Geschichtete Perovskite bilden natürlicherweise eine Quantenmuldenstruktur, bei der eine zweidimensionale Halbleiterschicht aus Metall-Halogenid-Oktaedem mit gemeinsamen Ecken und eine organische Schicht abwechselnd gestapelt sind.

Für die Herstellung derartiger organisch-anorganischer Hybridmaterialien sind Aufschleuder-Techniken geeignet, da viele organisch-anorganische Perovskite in herkömmlichen wäßrigen oder organischen Lösungsmitteln löslich sind. Unter Verwendung dieses Verfahrens wurden geschichtete Perovskit-Dünnfilme mit hoher Orientierung und hoher Qualität erzielt. Außerdem wurden Vakuum-Aufdampfungstechniken verwendet, um Filme aus geschichteten Perovskiten aufzuwachsen. Die gleichzeitig anhängige US-Patentammeldung, Seriennr. 192 130 mit dem Titel "Single-Source Thermal Ablation Method for Depositing Organic-Inorganic Hybrid Films" und die US-Patentammel-

4

dung Nr. 5 871 579 mit dem Titel "Two-Step Dipping Technique for the Preparation of Organic-Inorganic Perovskite Thin Films", die auf den Anmelder dieser Anmeldung übertragen wurden, beziehen sich beide auf alternative Depositionsverfahren für organisch-anorganische Hybridmaterialien. Die Offenbarung der zuvor erwähnten Anmeldungen wird hierin durch Verweis aufgenommen.

Demgemäß besteht eine Aufgabe dieser Erfindung darin, eine verbessarte FRT-Struktur bereitzustellen, die ein organisch-anorganisches Hybridmaterial als halbleitenden Kanal 10 verwendet.

Eine weitere Aufgabe dieser Erfindung besteht in der Bereitstellung einer verbesserten FET-Struktur, die mit geringen Kosten gefortigt werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Rine FRT-Struktur gemäß der Erfindung verwendet ein organisch-anorganisches Hybridmaterial als den halbleitenden Kanal zwischen Source- und Drainelektrode des Bau- 20 elements. Das organisch-anorganische Material kombiniert die Vorteile eines anorganischen, kristallinen Peststoffes mit jenen eines organischen Materials. Die anorganische Komponente bildet ein ausgedehntes, anorganisches ein-, zweioder dreidimensionales Netzwerk, um die Higenschaft hoher 25 Trägerbeweglichkeiten von anorganischen, kristallinen Feststoffen bereitzustellen. Die organische Komponente erleichtert den Selbstaufbau dieser Materialien und ermöglicht es, daß die Materialien durch einfache Niedertemperatur-Prozeßbedingungen, wie durch Aufschleudern, Eintauchbe- 30 schichtung oder thermische Verdampfung, aufgebracht werden. Die organische Komponente wird außerdem dazu verwendet, die elektronischen Eigenschaften des anorganischen Netzwerks maßzuschneidern, indem sie die Dimensionalität der anorganischen Komponente und die elektronische Kopplung zwischen anorganischen Einheiten definiert.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 stellt die Struktur eines Beispiels eines organischanorganischen Hybridmaterials dar, in diesem Fall basierend auf der Perovskit-Struktur.

Fig. 2 ist ein Röntgenbeugungsmuster (X-ray diffraction pattern) eines Phenethylammonium-Zinnio-did((PEA),SnL)-Films, der durch Aufschleudern in einer 45 TFT-Bauelementstruktur aufgebracht wurde.

Fig. 3 ist eine Querschnittansicht einer ersten TFT-Struktur, in die ein organisch-anorganisches Hybridmaterial als halbleitender Kanal eingebaut ist.

Fig. 4 ist eine Querschnittansicht einer zweiten TFT- 50 Struktur, in die ein organisch-anorganisches Hybridmaterial als halbleitender Kanal eingebaut ist.

Fig. 5 ist eine graphische Darstellung von I_{DS} in Abhängigkeit von Vers für einen TFT mit dem organisch-anorganischen Hybridmaterial (PEA)₂SnI₄ als dem aktiven Halbleistermaterial.

Fig. 6 ist eine graphische Darstellung von I_{DS} in Abhängigkeit von V_{DS} für einen TFT mit dem organisch-anorganischen Hybridmaterial (PEA)₂SnI₄ als dem aktiven Halbleitermaterial, das die besten bis heute erreichten Charakteristika zeigt.

Fig. 7 ist eine graphische Darstellung von $I_{\rm DS}$ in Abhängigkeit von $V_{\rm DS}$ für einen TFT mit dem organisch-anorganischen Hybridmaterial, das ein Alkyldiammonium-Kation (d. h. BDASnI4 (Butyldiammoniumzinniodid)) als das aktive Halbleitermaterial enthält.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Diese Brfindung verwendet organisch-anorganische Hybridmaterialien als halbleitende Kanāle in Dünnfilm-FETs. Organisch-anorganische Hybridmaterialien, die Komposite von organischen und anorganischen Materialien im molekularen Maßstab beinhalten, bieten potentiell böhere Trägerbeweglichkeiten als amorphes Silicium, während sie außerdem kostengünstig und leicht aufzubringen sind. Die anorganische Komponente liefert die Rigenschaft der bohen Beweglichkeit eines kristallinen, anorganischen Halbleiters, während die organische Komponente zum Selbstaufbau des Materials entweder aus einer Lösung oder aus der Gasphase beiträgt. Die organisch-anorganischen Hybridmaterialien können durch eine Anzahl von Techniken aufgebracht werden, die Aufschleuder-, Eintauchbeschichtungs- oder thermische Verdampfungstechniken umfassen. Wie bei organischen Halbleitern sind diese Verfahren kompatibel mit den Anforderungen sowohl hinsichtlich geringer Kosten als auch großflächiger Deposition für großflächige Anwendungen. Die Niedertemperatur-Prozeßbedingungen dieser Depositionstechniken eröffnen außerdem die Möglichkeit, diese Materialien auf Kunststoffsubstraten für flexible Anwendungen aufzubringen. Im Allgemeinen können organisch-anorganische Hybridmaterialien in allen Anwendungen ersetzend eingesetzt werden, die für organische Halbleitermaterialien entwickelt wurden. Zusätzlich zur Einfachbeit der Fertigung können die potentiell höheren Beweglichkeiten dieser Materialien ihre Anwendung auf Bauelemente mit höherer Geschwindigkeit ausdehnen, als es gegenwärtig mit entweder amorphem Silicium oder organischen Halbleitern möglich ist.

Die Erfindung beinhaltet einen Dünnfilm-FET mit einem organisch-anorganischen Hybridmaterial als der aktiven Halbleiterschicht. Fig. 1 stellt ein Beispiel eines organisch-anorganischen Hybridmaterials 10 dar, das auf einer dreidimensionalen Perovskit-Struktur ABX₃ basiert. Die Perovskit-Struktur ABX₃ basiert. Die Perovskit-Struktur BX₆-Oktaeder 12 mit gemeinsamen Ecken. Jeder Oktaeder 12 ist durch sechs X-Anionen an den Vertices und einem B-Kation in der Mitte definiert (siehe Kristallschema 18). Die A-Kationen sitzen in den großen Lücken zwischen den Oktaedern 12.

Anorganische geschichtete Verbindungen, die auf der dreidimensionalen Perovskit-Struktur basieren, kann man sich vorstellen, indem man einen "Schnitt" einer Dicke von n Schichten (n = 1 bis unendlich) entlang den <100>- oder <110>Ebenen des Perovskits nimmt. In den organisch-anorganischen Hybridmaterialien werden die anionischen, anorganischen BX6-Oktaeder der Perovakit-Lagen durch kationische, organische Moleküle 20 ladungsmäßig ausgeglichen, die alternierende Schichten bilden und/oder in den A-Kation-Zwischengitterplätzen sitzen. Beispiele für diese Materialien beinhalten B = Gruppe 14 (IV A), Übergangsmetallelemente und Elemente der seltenen Erden; X = Halogen (Cl, Br oder I) und A = organisches Ammonium- oder Diammonium-Kation. Das organische Ammonium- oder Diammonium-Kation kann aliphatisch, wie ein Alkan, oder aromatisch sein, wie in dem bereitgestellten Beispiel. Andere aromatische Molektile beinhalten heterozyklische Moleküle. Die organischen Moleküle können isolierend, wiederum wie in dem bereitgestellten Beispiel, oder halbleitend sein, wie Oligothiophene.

Anorganische Perovskit-Lagen 12 und organische Schichten 20 sind durch starke, ionische und Wasserstoff-Bindungen gebunden. Die ionische Bindung erfordert, daß die organisch-anorganische Verbindung eine spezifische Stöchiometrie aufweist und die organischen Molekille an gut definierten kristallographischen Stellen sitzen. Die Bin-

dung zwischen den organischen und anorganischen Schichten bewirkt, daß diese Hybridmaterialien als kristalline Dünnfilme aufgebracht werden oder als Einkristalle aufwachsen.

Fig. 2 ist ein Röntgenbeugungsmuster des organisch-anorganischen Hybridmaterials Phenethylammoniumzinniodid (PEA)₂SnL, das in einer TFT-Bauelementstruktur aufgebracht ist. Das Vorhandensein lediglich der (001)-Reflektionen demostriert, daß sich das Material als gut orientierer, kristalliner Dünnfilm abscheidet, wobei die organischen 10 und anorganischen Lagen parallel (oder mit senkrechter e-Achse der Struktur) zu dem Halbleitersubstrat liegen.

Die oben beschriebenen organisch-anorganischen Perovakita ebenso wie andere organisch-anorganische Hybridmaterialien kombinieren die Vorteile eines anorganischen, kristallinen Halbleiters mit jenen eines organischen Materials. Die anorganische Komponente bildet ein ausgedehntes, anorganisches ein-, zwei- oder dreidimensionales Netzwerk, um potentiell die Eigenschaft der hohen Trägerbeweglichkeiten von anorganischen, kristallinen Feststoffen bereitzu- 20 stellen. Die organische Komponente erleichtert den Selbataufbau dieser Materialien, Dies ermöglicht, daß die Materialien durch einfache Niedertemperatur-Prozesbedingungen, wie Aufschleudern, Eintauchbeschichtung oder thermische Verdampfung, aufgebracht werden. Die organische Komponeute wird außerdem dazu verwendet, die elektronischen Bigenschaften des anorganischen Netzwerks maßzuschneidem, indem sie die Dimensionalität der anorganischen Komponents und die elektronische Kopplung zwischen anorganischen Kinheiten definiert.

Fig. 3 zeigt eine Querschnittansicht einer typischen TFT-Bauelementstruktur 30. Der TFT 30 beinhaltet eine Schicht 32 aus organisch-anorganischem Hybridmaterial. Die Schicht 32 ist ein organisch-anorganischer Perovskit und dient als halbleitender Kanal zwischen Source- und Drainelektroden 34 und 36. Die Orientierung des Materials, wie aus der Röntgenstrahlbeugung ersichtlich, ist derart, daß die zweidimensionalen anorganischen Lagen 12 die elektrische Verbindung zwischen Source- und Drainelektroden 34 und 36 liefern. Die Konduktanz des organisch-anorganischen Halbleiters wird über eine elektrisch isolierende Schicht 38 hinweg, wie einen dännen SiO₂-Film, durch eine Gate-Elektrode 40 (wie eine entartet dotierte n⁺⁺-Siliciumschicht) moduliert, die sämtlich von dem Substrat 42 getragen sind.

Das organisch-anorganische Hybridmaterial 32 kann entweder vor oder nach der Metalldeposition der Source- und
Drainelektroden 34 und 36 aufgebracht werden. Eine erst
danach erfolgende Aufbringung von organisch-anorganischem Hybridmaterial 32 reduziert das Maß, in welchem
das Material potentiell schädigenden, hoben Temperaturen 50
während einer Metallisierung ausgesetzt ist.

Wenngleich Fig. 3 eine typische FET-Strukturanordnung darstellt, werden auch alternative Strukturen als innerhalb der Grenzen der Erfindung angesehen. Siehe Fig. 4, in der die jeweiligen Elemente einer alternativen FBT-Struktur 55 dargestellt und idemisch zu Fig. 3 bezeichnet sind. Alternative Substrate umfassen Kunststoffe, wie Polyimid und Polycarbonat, die dazu verwendet werden können, flexible Bauelemente aufzubauen, In einer derartigen Anordnung werden strukturierte Metall-Gateelektroden auf dem Substrat entweder durch eine Schattenmaske oder durch Photolithographie aufgebracht. Der Gate-Isolator wird dann durch eines einer Vielzahl von Verfahren aufgebracht, die Aufschleudern, chemische Gasphasenabscheidung, Sputtern oder Vaknumdeposition umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Das organisch-anorganische Hybridmaterial sowie Source- und Drain-Elektroden werden dann aufgebracht, wie oben beschrieben.

In Fig. 5 sind vorläufige Daten gezeigt, welche die gewünschte feldmodulierte Konduktanz und Stromsättigung für einen TFT darstellen, der mit dem organisch-anorganischen Hybridmaterial (PEA)2SnI4 hergestellt wurde. In dem vermessenen Bauelement wurde eine (PBA)2SnI4-Schicht von ~ 100 Å aus Acetonitril auf ein 5.000 Å dickes SiO₂-Gateoxid aufgeschleudert. Der halbleitende Kanal war durch Au-Elektroden zu einer Länge von 70 µm und einer Breite von 1.500 µm definiert. Im Allgemeinen bilden Metalle mit hoher Austrittsarbeit, wie Au, Pd und Pt, "gute" ohmsche Kontakte zu diesem organisch-anorganischen Hybridmaterial. (PRA)2SnL ist ein "p-leitendes" Material, da es Löcher durch die Halbleiterschicht transportiert, Dies ist offensichtlich, da der Stromfluß durch den halbleitenden Kanal (ID) mit zunehmender negativer Gate-Vorspannung (V_G) und Source-Drain-Spannung (V_{DS}) zunimmt. Fig. 6 ist eine graphische Darstellung von I_{DS} in Abhängigkeit von V_{DS} für einen TFT mit dem organisch-anorganischen Hybridmaterial (PRA)2SnL als dem aktiven Halbleitermaterial, das die besten Rigenschaften zeigt, die bis heute erzielt wur-

Fig. 7 ist eine graphische Darstellung von I_{DS} in Abhängigkeit von V_{DS} für einen TFT mit dem organisch-anorganischen Hybridmaterial, das ein Alkyldiammonium-Kation (d. h. BDASnI₄ (Butyldiammoniumzinniodid) als aktives Halbleitermaterial enthält.

Wenngleich Beweglichkeiten von 0,06 cm²/V·sec bis 0,25 cm²/V·sec niedriger als die erwarteten intrinsischen Werte sind, kommen sie bereits jenen von amorphem Sili30 cium und jenen der besten organischen Halbleiter nabe.

Bemerkenswerterweise sind diese Beweglichkeiten höber als filr aufgeschleuderte organische Halbleiter. Es wird erwartet, daß die Erzielung der höheren intrinsischen Beweglichkeiten erreichbar ist. Wenngleich Feldeffektbeweglichkeiten nicht gemessen wurden, liegen Berichte von Hall-Effekt-Beweglichkeiten im Bereich von 1 cm²/V sec bis 100 cm²/V · sec. Wenngleich die Beziehung zwischen Hall-Beweglichkeiten und Peldeffektbeweglichkeiten komplex sein kann, wird in einer einfachen Theorie angenommen. daß sie proportional sind. Daher legen es diese hohen Hall-Effekt-Beweglichkeiten nahe, daß ähnlich hohe Feldeffekt-Beweglichkeiten erzielt werden können, die jene von amorphem Silicium übersteigen. Zusätzlich dazu, daß die organisch-anorganischen Hybridmaterialien bobe Beweglichkeiten versprechen, können sie auch durch kostengünstigere Prozeßtechniken als jene aufgebracht werden, die für anorganische Feststoffe üblich sind. Die Techniken umfassen Aufschleudern, Eintsuchbeschichtung oder thermische Verdampfung.

Die elektronischen Eigenschaften von organisch-anorganischen Hybridmaterialien können durch die Chemie maßgeschneidert werden. Es gibt einen weiten Bereich von organischen und anorganischen Komponenten, die als das organisch-anorganische Hybridmaterial verwendet werden können, Die einzige Anforderung für diese Anwendung besteht darin, daß eine oder beide der organischen und anorganischen Komponenten halbleitend ist/sind. Materialien mit gewünschten Eigenschaften können durch Wählen der Chemie, der Kristallstruktur und der Dimensionalität der anorganischen Komponente sowie der Länge und der chemischen Funktionalität der organischen Komponente entworfen werden. Die Flexibilität der Chemie von organisch-anorganischen Hybridmaterialien kann dazu verwendet werden, sowohl n- als auch p-leitende Transportmaterialien herzustellen, die für komplementär-logische und normale Einoder Aus-TFTs erwünscht sind.

Es versteht sich, daß die vorstehende Beschreibung lediglich illustrativ für die Erfindung ist. Verschiedene Alternati-

10

11. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 1 angegeben,

wobei das Substrat ein Kunststoffmaterial beinhaltet.

ven und Modifikationen können durch einen Fachmann ohne Abweichung von der Erfindung in Betracht gezogen werden. Demgemäß ist die vorliegende Erfindung so gedacht, daß sie alle derartigen Alternativen, Modifikationen und Variationen umfaßt, die in den Umfang der beigefügten 5 Ansprüche fallen,

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

Patentansprüche

1. Feldeffekttransistor mit:
einem Source-Bereich und einem Drain-Bereich;
einer Kanalschicht, die sich zwischen dem Source-Bereich und dem Drain-Bereich erstreckt, wobei die Kznalschicht ein halbleitendes, organisch-anorganisches Hybridmaterial beinhaltet;
einem Gate-Bereich, der in beabstandeter Nachbarschaft zu der Kanalschicht angeordnet ist, und einer elektrisch isolierenden Schicht zwischen dem Gate-Bereich und dem Source-Bereich, dem Drain-Bereich und der Kanalschicht.

2. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 1 angegeben, wobei der Source-Bereich, die Kanalschicht und der Drain-Bereich auf einer Oberfläche eines Substrates angeordnet sind, wobei die elektrisch isolierende Schicht über der Kanalschicht angeordnet ist und sich 25 von dem Source-Bereich zu dem Drain-Bereich erstreckt und wobei der Gate-Bereich über der elektrisch isolierenden Schicht angeordnet ist.

 Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 1 angegeben, wobei der Gate-Bereich als Gateschicht auf einer Oberfläche eines Substrates angeordnet ist, die elektrisch isolierende Schicht auf der Gate-Schicht angeordnet ist und der Source-Bereich, die Kanalschicht sowie der Drain-Bereich auf der elektrisch isolierenden Schicht

angeordnet sind.

- 4. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 1 angegeben, wobei das organisch-anorganische Hybridmaterial ein Material ist, das besteht aus: organischen Komponenten und anorganischen Komponenten, die auf einem molekularen Niveau zusammengemischt sind, und wobei (i) das Material durch ein im wesentlichen festes Verhältnis jeder organischen Komponente zu jeder anorganischen Komponente charakterisiert ist; wobei (ii) wenigstens eine Komponente halbleitend ist; und wobei (iii) sowohl die organische als auch die anorganische Komponente Kräfte zeigen, die einen Selbstaufbau zwischen diesen in eine vorhersagbare Anordnung ermöglichen.
- 5. Peldeffekttransistor, wie in Anspruch 1 angegeben, wobei das halbleitende, organisch-anorganische Hy- 50 bridmaterial eine anorganische Komponente mit einer kristallinen Perovskit-Struktur beinhaltet.
- 6. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 5 angegeben, wobei das halbleitende, organisch-anorganische Hybridmaterial ein Alkylmonoammonium-Kation bein- 55 haltet.
- 7. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 5 angegeben, wobei das halbleitende, organisch-anorganische Hybridmaterial Phenethylammoniumzinniodid (PEA)₂SnI₄ ist.
- 8. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 5 angegeben, wobei das halbleitende, organisch-anorganische Hybridmaterial ein Alkyldiammonium-Kation beinhaltet.
 9. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 8 angegeben, wobei das halbleitende, organisch-anorganische Hybridmaterial BDASnI4 (Butyldiammoniumzimiodid) als Halbleitermaterial ist.
- 10. Feldeffekttransistor, wie in Anspruch 1 angegeben,

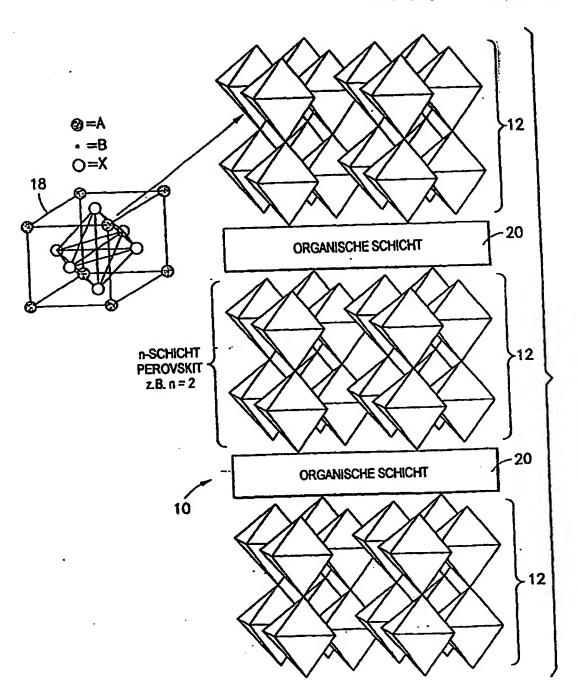


FIG.1

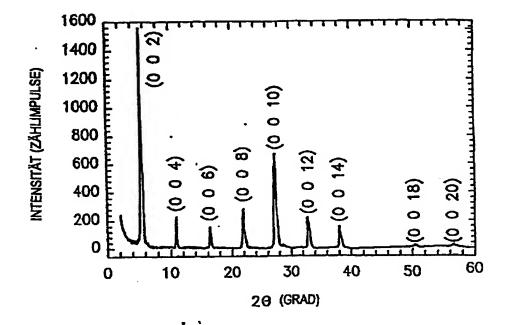


FIG.2

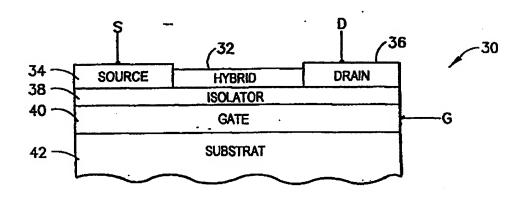


FIG.3

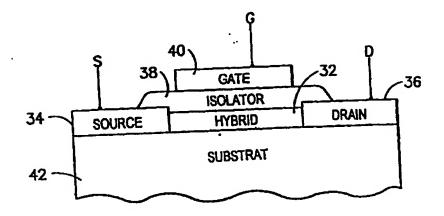


FIG.4

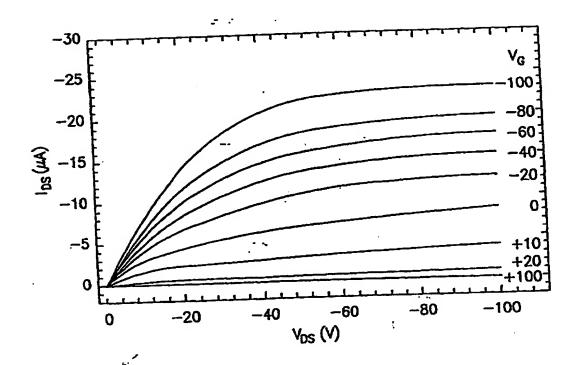
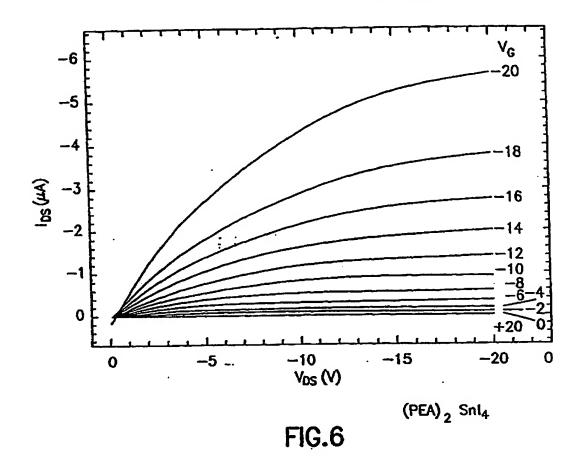


FIG.5

Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag: DE 100 06 257 A1 H 01 L 29/785 14. September 2000



Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 06 257 A1 H 01 L 29/785 14. September 2000

